

砷化鎵太陽電池之製程研究

林裕鈞、蕭宏彬；周鵬程

E-mail: 9708113@mail.dyu.edu.tw

摘要

由於太陽能源的收集和面積有著極大的關係，在固定的轉換效率之下，面積越大所能收集的能量將越大，而元件面積越大，將電流導出的金屬線面積也就越大，所需的金屬材料就越多，進而所需的製造成本就相對提高。過去，在砷化鎵上常使用的金屬材料為金，然而金為貴重金屬，價格昂貴，為降低砷化鎵系列太陽電池的製造成本，在本研究中，吾人嘗試以銀、鋁、銅為主體材料在重摻雜的n型砷化鎵上製作歐姆接觸電極，並探討其熱穩定性。在重摻雜n型砷化鎵上蒸鍍三種不同的金屬組成，分別為Ni/Ag/Au、Ni/Al/Au與Ni/Cu/Au，將試片分成數批經歷不同的退火條件，接著利用傳輸線模型(TLM)量測其金屬材料和半導體之間的接觸特徵電阻(c)，以X光繞射儀(XRD)探討金屬材料和半導體之間的界面相互擴散情形。

關鍵詞：無合金歐姆接觸；退火；傳輸線模型

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書	iii 中文摘要
iv 英文摘要	v 誌謝
vi 目錄	vii 圖目錄
ix 表目錄	xii 第
第一章 序論 1.1 前言	1 1.2 研究背景與動機
1 1.3 本文架構	2 第二章 理論介紹
3 2.1 太陽電池介紹	3 2.1.1 太陽電池之理論
3 2.2 太陽電池分類	3 2.1.2 砷化鎵太陽電池的優點
8 2.2.1 歐姆接觸理論	11 2.2.1 金屬與半導體接觸理論
12 2.2.2 電流傳導機制	19 2.2.2 傳輸線模型理論
20 2.2.3 砷化鎵歐姆接觸技術	22 2.3 傳輸線模型理論
24 第三章 元件實驗內容	27 3.1 歐姆接觸製程
27 3.2 相關儀器設備	32 3.2.1 有機金屬氣相磊晶
32.2 微影製程	33 3.2.3 蒸鍍機
38 第四章 結果分析與討論	36 3.2.4 X光繞射儀
41 4.2 XRD比較	41 4.1 TLM比較
59 參考文獻	49 第五章 結論
	60

參考文獻

- [1] N. Stavitski, 1 M. J. H. van Dal, 2 R.A.M. Wolters, 1,3 A.Y. Kovalgin, 1 J. Schmitz, " Specific Contact Resistance Measurements of Metal-Semiconductor Junctions ", Proceedings of the IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures (ICMTS), 6-9 Mar 2006, Austin, TX, USA. pp. 13-17.
- [2] L K Makt, C M Rogers and D C Northrop, " Specific contact resistance measurements on semiconductors ", J. Phys. E: Sci. Instrum. 22 (1989) 317-321. Printed in the UK.
- [3] S. O. Kasap, " Optoelectronics and photonics principles and practices ", Prentice Hall, pp. 286-305(2003).
- [4] 李岳穆，“在矽基板上研製砷化鎵太陽能電池”，大葉大學電機研究所碩士論文, 96年6月(2007).
- [5] R. Stangl, A. Froitzheim, M. Schmidt, W. Fuhs, " Design Criteria For Amorphous/Crystalline Silicon Heterojunction Solar Cells-A Simulation Study ", 3rd IEEE Photovoltaic Energy Conversion, Vol. 2, pp. 1005-1008, 2003.
- [6] 莊嘉琛，“太陽能工程(太陽電池篇)”，全華科技圖書股份有限公司, pp. 135-137(2001).
- [7] Donald A. Neamen, Semiconductor Physics and Devices, 3rd ed (McGraw-Hill, New York, 2003).
- [8] E. H. RHODERICK, R. H. WILLIAMS, " Metal - Semiconductor Contacts ", 2nd ed pp.63-82, 1988.
- [9] 陳立干，“p型氮化鎵低電阻歐姆接面微結構研究”，國立清華大學工程與系統科學系博士論文, 89年6月(2000).
- [10] A.G. Baca, F. Ren, J.C. Zolper, R.D. Briggs, S.J. Pearton, " A survey of ohmic contacts to III-V compound semiconductors ", Thin Solid

Films Vol. 308-309, pp 599-606, 1997.

[11] 林裕鈞 , 賴裔澄 , 蕭宏彬, " Ni/Ag/Au與AuGeNi/Ag/Au在重摻雜n-型砷化鎵上形成無合金歐姆接觸之特性研究 ",第六屆微電子技術與應用研討會(2008).

[12] H. GEORGE HENRY, " Characterization of Alloyed AuGeInAlAu Ohmic Contacts to n-Doped GaAs by Measurement of Transfer Length and Under the Contact Sheet Resistance ", IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES. Vol.. 36. NO. 1. 1989.

[13] 張景學,吳昌崙, " 半導體製程技術 ",文京圖書有限公司,pp195-208(2000).